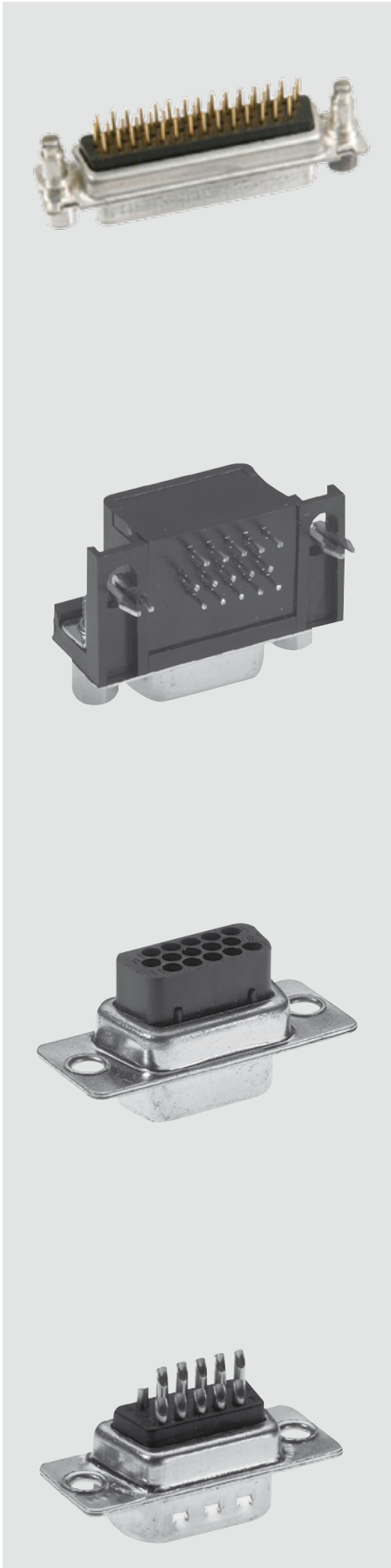


## High Density D-Sub Steckverbinder

## High Density D-Sub Connectors



Die High Density D-Sub Steckverbinder von Provertha sind mit gedrehten Kontakten, Metall-Gehäuse in Stift-Version mit Schirm-Feder-Kontur und massives Befestigungszubehör für hochwertige Anwendungen ausgelegt wie z. B. spezielle EMV-Anforderungen. Die Kernkompetenz in Entwicklung und Fertigung aus dem breit gefächerten D-Sub Steckverbinderprogramm wird für das High Density D-Sub Programm mit innovativen Produkten und speziellem Kundennutzen angewandt.

- 360° EMI/RFID-Sub Vollmetall-Hauben mit vibrationssicherer Zugentlastung durch Crimpflansch-System
- QuickLock: innovatives Push-Pull Verriegelungssystem für D-Sub-Hauben

### High Density D-Sub Programm

- High Density D Sub Steckverbinder für Platinenmontage in den Anschlussarten: Einlöt 90° und 180°,
- High Density D Sub Steckverbinder für Kabelmontage in den Anschlussarten: Crimp, Handlöt
- High Density Crimpkontakte in gestanzter und gedrehter Version
- DualPort D-Sub Steckverbinder
- Kunststoffhauben für High Density D-Sub
- 360° EMI/RFI Vollmetallhauben für High Density D-Sub für hohe EMV-Anforderungen in der Bahntechnik und dem Maschinenbau
- Push-Pull D-Sub Verriegelungssystem: Quicklock
- Crimp- und Verarbeitungs-Werkzeuge
- Zubehör

The High Density D-Sub connectors by use of turned contacts, metal shell in male version with dimple grounding and solid mounting accessories are the ideal solution for applications with special performance requirements such as special EMC demands. The core competence in development and production from the broad range of the D-Sub connector products is used for the High Density D-sub product range and for innovative High Density D-Sub products with special customer benefits like

- 360° EMI/RFID-sub die-cast hoods with vibration-proof strain relief due to crimp flange system
- QuickLock: groundbreaking push-pull latching system for D-Sub-hoods

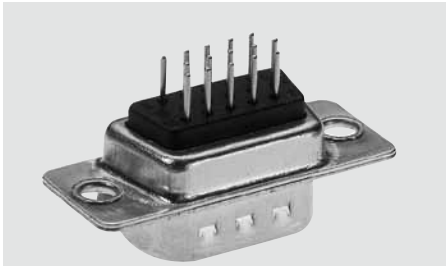
### High Density D-Sub product range

- High Density D Sub connectors for pcb assembly in the termination styles: solder pin 180° and solder pin 90°
- High Density D Sub connector for cable assembly in the termination styles: crimp, hand solder
- High Density D-Sub Crimp contacts in stamped and turned version
- DualPort D-sub connectors
- Plastic and metallized hoods for high density D-sub
- 360° EMI/RFI die-cast hoods for high density D-Sub for high EMV demands in railway technology and engineering
- Push-pull D-sub locking system: Quicklock
- Crimp and processing tools
- Accessories

<b>Technische Informationen / Technical Information</b>	
<b>Technische Daten / Technical Data</b>	
Strombelastbarkeit in A (DC) bei 20° C <i>Current rating in A (DC) at 20° C</i>	VDE: 3,5A; CSA: 2,5 A; UL: 3 A
Betriebsspannung / <i>Working Voltage</i>	60 V
Prüfspannung U eff in V / <i>Test voltage U eff in V</i>	1000
Luft- und Kriechstrecken in mm <i>Air and creepage distance in mm</i>	min. 0,6
Durchgangswiderstand in mW <i>Resistance in mW</i>	≤ 10
Isolationswiderstand in GW <i>Insulation resistance in GW</i>	≥ 10
Temperaturbereich in °C <i>Temperature range in °C</i>	-55 ... +125
<b>Gesamt-Steck-/Ziehkraft in N / Mating/unmating force fully loaded connector in N</b>	
15pos	≤ 50
26pos	≤ 84
44pos	≤ 120
62pos	≤ 170
78pos	≤ 200
<b>Materialien / Materials</b>	
Isolierkörper / <i>Insulators</i>	PBT GF UL 94-V0
Kontaktmaterial / <i>Contact material</i>	Cu-Legierung / <i>Cu alloy</i>
Kontaktoberfläche / <i>Contact plating</i>	Steckbereich: Au über Ni / <i>Mating area: Au over Ni</i> Anschlussbereich: Sn über Ni / <i>Termination area: Sn over Ni</i>
Gehäuse / <i>Housing</i>	Stahl verzinkt / <i>St. tinned</i>

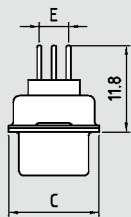
## High Density Einlöt 180° mit gedrehten Kontakten

## High Density Dip solder 180° with machined contacts

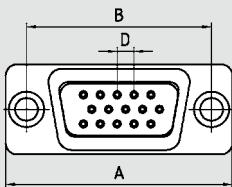
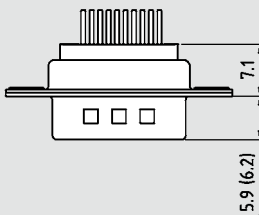


- Gedrehte Präzisionskontakte
- Vollvergoldet über Nickel-sperrschicht
- Höchste Güte und Lebensdauer durch definierte Kontaktzone
- Strombelastbarkeit bei 20° C 3A

- High precision machined contacts
- Fully gold plated over nickel base layer
- Best quality and long life due to specified contact area
- Current rating 20° C 3A



Stift (Buchse)  
Pin (socket)



### Abmessungen / Dimensions

Polzahl Size	15	26	44	62	78
A	30.8	39.1	53.0	69.3	67.0
B	25.0	33.3	47.0	63.5	61.1
C	12.2	12.2	12.2	12.2	15.2
D	2.286	2.286	2.286	2.413	2.413
E	2x1.981	2x1.981	2x1.981	2x1.981	3x2.083

### Einlötanschluß, verzinnertes Metallgehäuse Dip solder version, tin-plated metal shell

Polzahl Size	Stift Pin	Buchse Socket
15	HDT 15 52 G .	HT 15 62 G .
26	HDT 26 52 G .	HT 26 62 G .
44	HDT 44 52 G .	HT 44 62 G .
62	HDT 62 52 G .	HT 62 62 G .
78	HDT 78 52 G .	HT 78 62 G .

### Einlötanschluß mit Gewindeniet, verzinnertes Metallgehäuse Dip solder version with riveted thread, tin-plated metal shell

Polzahl Size	Stift Pin	Buchse Socket
15	H45DT 15 52 G .	H45T 15 62 G .
26	H45DT 26 52 G .	H45T 26 62 G .
44	H45DT 44 52 G .	H45T 44 62 G .
62	H45DT 62 52 G .	H45T 62 62 G .
78	H45DT 78 52 G .	H45T 78 62 G .

**!** Bitte anstelle des Punktes ( . ) am Ende der Artikelnummer die gewünschte Gütestufe 1, 2 oder 3 einsetzen.

Selektive Kontaktbestückung möglich.

Bei M3 Gewinde die Ziffer 4 nach dem „H“ gegen eine 3 austauschen.

Gewinde und Befestigungsvariationen siehe Seite 38.

For the requested quality class please replace the point ( . ) at the end of the part no. by using the number 1, 2 or 3.

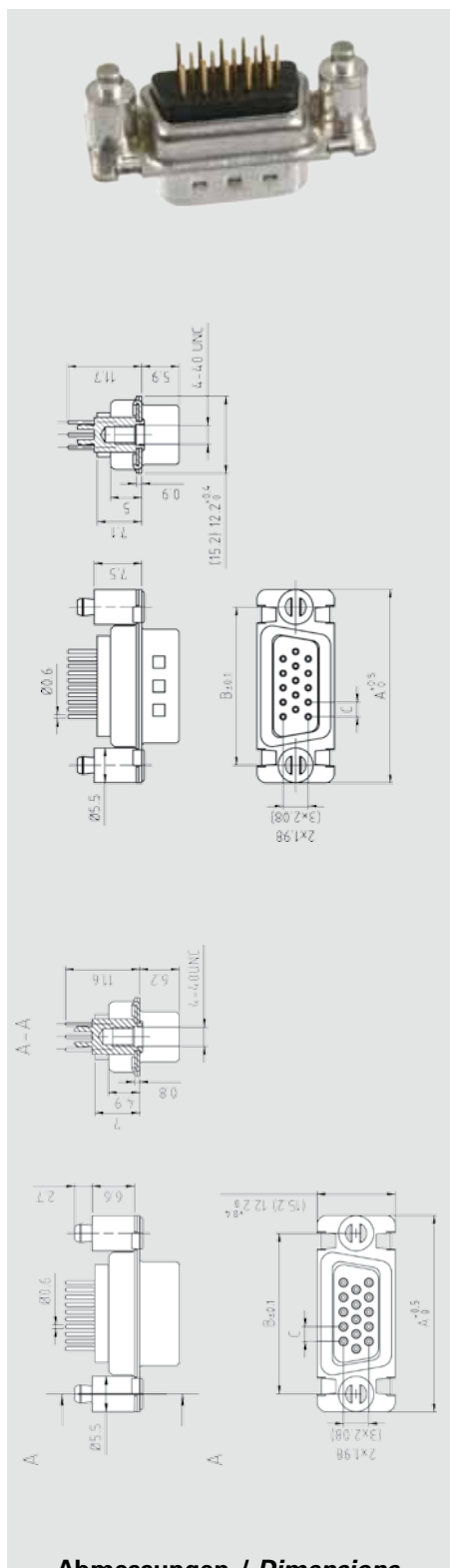
Individual contact loading possible.

For M3 thread please replace the figure 4 after the "H" by the -figure 3.

Different threads and fastening variations on page 38.

**High Density Boardlock  
Einlöt 180°  
gedrehte Kontakten**

**High Density Boardlock  
dip solder 180°  
machined contacts**



- Befestigungsclip und Abstandhalter mit Gewinde in einem
- In einem Arbeitsgang wird der Stecker auf der Platine eingerastet, auf richtigen Abstand fixiert und bietet ein UNC4-40 Gewinde zum Befestigen an;
- Dadurch sichere und rationelle Platinenmontage möglich
- Hochwertige, präzise gedrehte Clipbolzen
- Als Boardlock ohne Bolzen verfügbar
- Gedrehte Kontakte selektiv vergoldet

- Mounting lug distance spacer and threaded rivet in one part
- The connector is snapped into the circuit board in one operation, is exactly spaced and is fixed by an UNC 4-40 thread.
- Safe and efficient board assembly
- High quality precision turned locking system
- Available as board lock without bolt
- Machined contacts stamped selectively gold plated

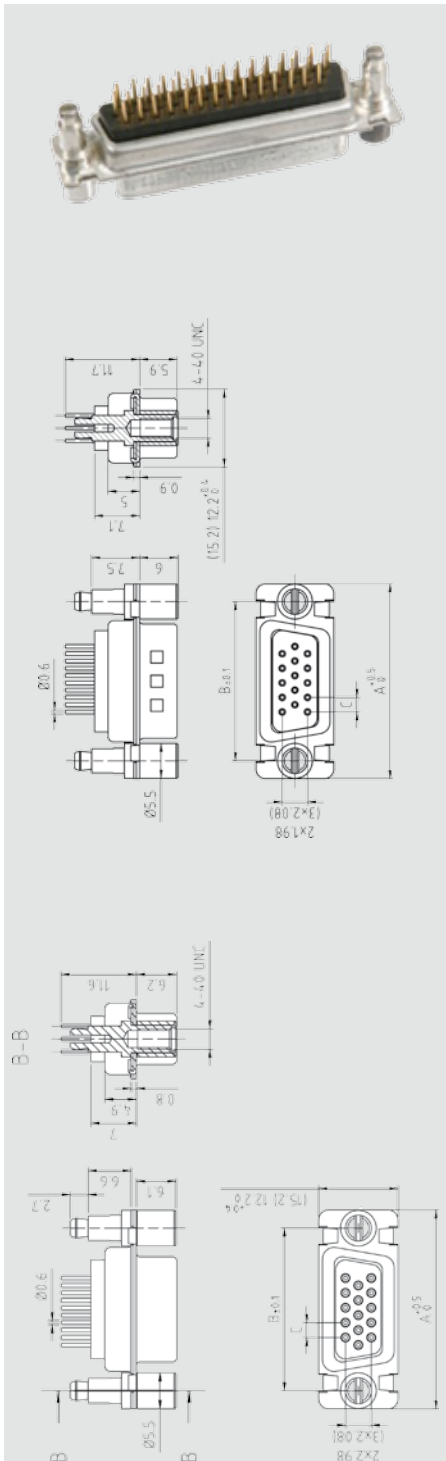
<b>Boardlock Boardlock</b>		
<b>Polzahl Size</b>	<b>Stift Pin</b>	<b>Buchse Socket</b>
15	BL4HDT 15 52 G .	BL4HT 15 62 G .
26	BL4HDT 26 52 G .	BL4HT 26 62 G .
44	BL4HDT 44 52 G .	BL4HT 44 62 G .
62	BL4HDT 62 52 G .	BL4HT 62 62 G .
78	BL4HDT 78 52 G .	BL4HT 78 62 G .

**Abmessungen / Dimensions**

<b>Polzahl Size</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>44</b>	<b>62</b>	<b>78</b>
A	30.6	39.0	52.8	69.2	66.6
B	25.0	33.3	47.0	63.5	61.1
C	2.286	2.286	2.286	2.413	2.413

## High Density Combilock Einlöt 180° gedrehte Kontakten

## High Density Combilock dip solder 180° machined contacts



- Befestigungsclip, Abstandhalter und Gewindebolzen in einem
- In einem Arbeitsgang wird der Stecker auf der Platine eingerastet, auf richtigen Abstand fixiert und bietet ein UNC4-40 Gewinde zum Befestigen an;
- Dadurch sichere und rationelle Platinenmontage möglich
- Hochwertige, präzise gedrehte Clipbolzen
- Gedrehte Kontakte selektiv vergoldet

- *Mounting lug distance spacer and threaded rivet bolt in one part*
- *The connector is snapped into the circuit board in one operation, is exactly spaced and is fixed by an UNC 4-40 thread.*
- *Safe and efficient board assembly*
- *High quality precision turned locking system*
- *Available as board lock without bolt*
- *Machined contacts stamped selectively gold plated*

Combilock Combilock		
Polzahl Size	Stift Pin	Buchse Socket
15	B4HDT 15 52 G .	B4HT 15 62 G .
26	B4HDT 26 52 G .	B4HT 26 62 G .
44	B4HDT 44 52 G .	B4HT 44 62 G .
62	B4HDT 62 52 G .	B4HT 62 62 G .
78	B4HDT 78 52 G .	B4HT 78 62 G .

### Abmessungen / Dimensions

Polzahl Size	15	26	44	62	78
A	30.6	39.0	52.8	69.2	66.6
B	25.0	33.3	47.0	63.5	61.1
C	2.286	2.286	2.286	2.413	2.413

**High Density D-Sub  
Leiterplattenlochbilder**

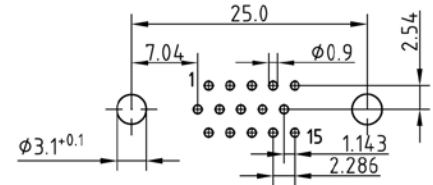
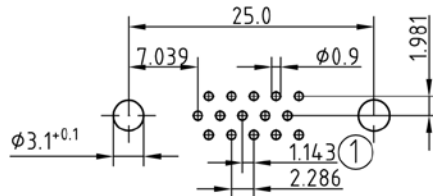
**High Density D-Sub  
PCB Hole Pattern**

**Einlöt 180°  
Dip solder 180°**

**Einlöt 90°  
Dip solder 90°**

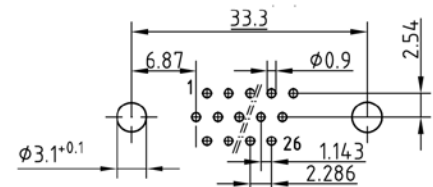
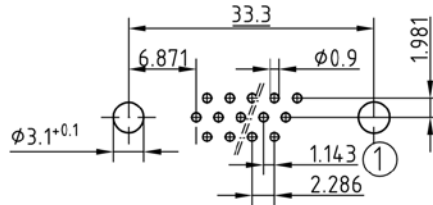
**15-polig / 12 poles**

**15-polig / 12 poles**



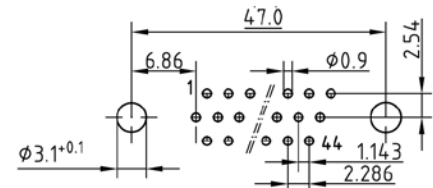
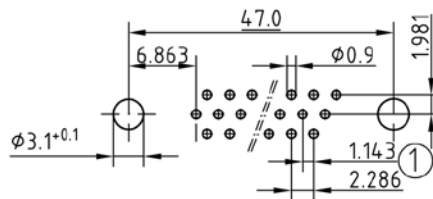
**26-polig / 26 poles**

**26-polig / 26 poles**



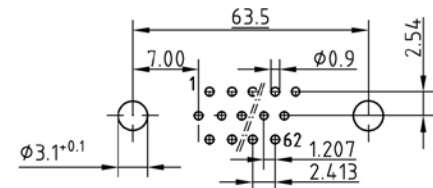
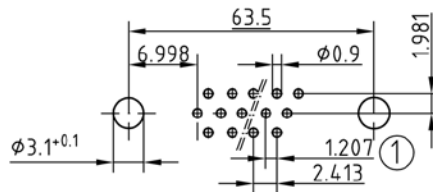
**44-polig / 44 poles**

**44-polig / 44 poles**



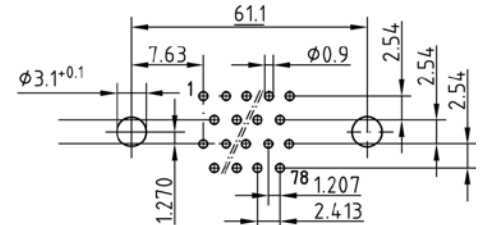
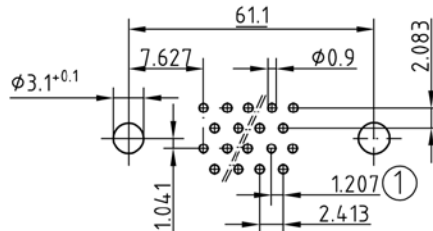
**62-polig / 62 poles**

**62-polig / 62 poles**



**78-polig / 78 poles**

**78-polig / 78 poles**



**Hinweis**  
Buchse gespiegelt an Y-Achse

**Note**  
Female mirrored on Y-axis